

# 方形Ptfе晶圆清洗篮 氟聚合物半导体蚀刻架 定制硅片承载器

货号: PL-CP89



## 简介

使用我们定制的方形PTFE晶圆清洗篮优化半导体湿法工艺。专为极端耐化学性和高纯度处理而设计，这些氟聚合物承载器为关键的硅片蚀刻和清洗提供了卓越的耐用性和精度。

## [了解更多](#)

应用领域	描述	主要优势
硅片蚀刻	将基板浸入酸性蚀刻剂中以去除表面层或创建特定纹理。	对HF和硝酸混合物具有卓越的耐受性。
太阳能电池清洗	在掺杂或涂层前对大尺寸方形光伏晶圆进行多级清洗。	大容量处理能力，破损率极低。
MEMS加工	在关键的化学释放步骤中处理微机电系统。	高纯度环境防止微观污染。
超声波清洗	在超声波槽内使用，去除精密光学器件或电子元件上的亚微米颗粒。	阻尼特性保护精密部件免受振动损伤。
痕量金属分析	在分析化学中，为高纯度酸浴中的实验室器皿进行制备和清洗。	为十亿分之一（PPB）级别的检测提供尽可能低的背景干扰。
LED基板处理	在严苛的清洗和漂洗周期中支撑蓝宝石或碳化硅晶圆。	在高温化学工艺中长期可靠。
化学品存储与运输	在洁净室模块间运输过程中，安全容纳敏感基板。	非反应性表面保护晶圆表面化学性质。
实验室研究	为大学和研发实验室的实验性材料处理提供定制尺寸的承载器。	适应性设计，可适应非标准实验设置。

规格类别	PL-CP89参数详情
型号标识	PL-CP89
标准尺寸	249mm x 249mm (方形配置)
材料成分	100% 高纯度PTFE (聚四氟乙烯)
化学兼容性	通用 (除熔融碱金属和单质氟外)
温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
制造方法	整块坯料全CNC加工
晶圆容量	完全可定制 (可变槽口数量和间距)
槽口宽度	精密加工 (可根据晶圆厚度定制)
排水特性	集成底座和侧面流通孔，便于流体交换
手柄选项	可选配可拆卸或集成式PTFE手柄
表面处理	光滑、无孔的机加工表面，防止颗粒滞留
合规性	符合RoHS标准，FDA级原材料